



中華民國專利證書

發明第 I 898953 號

發明名稱：具有高銅瘤分布密度的低粗糙度銅箔、其製作方法及包括其的銅箔基板

專利權人：南亞塑膠工業股份有限公司

發明人：袁敬堯、鄭維昇、謝育淇

專利權期間：自 2025 年 9 月 21 日至 2044 年 12 月 8 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國



114

年

9

月

21

日

